

月度市场报告

海力士、三星、镁光、闪迪等多家存储原厂1月价格涨幅超50%

2026年1月刊

新汉科技

仅供内部使用

目录

本月重点.....	3
原厂动态.....	4
行业趋势.....	10
高风险物料预警	15

本月重点

1. 海力士本月价格暴涨 60%
2. 三星官方通知普通客户涨价 100%
3. 镁光 DRAM 合约价环比增长 55-60%
4. 闪迪企业级 SSD 价格翻倍
5. ST 优先保障通用 MCU 和电源产品供应
6. 安世半导体多个产品线面临交付压力

本报告每月发布一次，部分消息源自于我们供应商或客户的所见及所闻，部分消息来自于渠道直接或间接提供。本报告由新汉科技整理并做简单分析，并不代表新汉科技观点及立场，仅供参考与学习。网络消息繁杂，请大家注意甄别。

原厂动态

ST 产能优先保障通用 MCU 和电源产品

ST 成熟制程目前优先保障通用 MCU 和电源 IC 的供应。12 英寸晶圆产线扩产 SiC 和车规级 MCU 以满足新能源与汽车电子领域的需求。而供应端车规级功率器件、SiC MOSFET 受新能源汽车与光伏需求拉动，产能想车规倾斜，交期普遍在 12-16 周。工业级功率器件及 MCU 交期在 8-12 周。需求端则是汽车电子（车规 MCU/功率器件）、工业控制需求支撑其产品价格坚挺。通用消费级 MCU 现货充足，价格平稳无明显波动，AIOT（MEMS 传感器）订单饱和，价格平稳。

TI 汽车类产品价格依旧坚挺

在汽车电动化、智能化、联网化的趋势下，新能源汽车中的车身控制、电源管理、电机控制驱动、车载影音娱乐、车载照明等系统都带动了模拟芯片的需求。其中车规级 PMIC、BMS 隔离芯片等品类均为涨价的重点，如 TPS65XXX-Q1 系列，TPS7AXXX-Q1 系列，ISO77XXX-Q1 系列，ISO15XXX-Q1 系列，SN650XXX-Q1 系列和 BQ79600-Q1 系列。TI 以利润增长为核心，部分物料不定期涨价，如 TPS、OPA 和 MSP 系列。现货市场随着出货速度的不同亦有不同程度的涨价，更有甚者开始囤货，留着涨价再售。交期方面，TI 近期交期拉长，一是因为晶圆厂产能不足，二是因为 Q1 客户需求暴增，常规型物料交期至少 2 周以上。

封测原材料短缺导致 Microchip 交期延长

Microchip 宣布推出专为 NVIDIA DGX Spark 个人 AI 超级计算机定制设计的 MEC1723 嵌入式控制器 (EC) 固件，进一步优化 MEC1723 EC 在 NVIDIA DGX 平台上管理 AI 工作负载的能力。Microchip 致力于通过控制器固件创新，提升严苛的 AI 计算架构的性能与安全性。

Microchip 预计 2026 年将持续缺货，且交期延长，主要原因是封测原材料短缺。当行业进入上行周期或技术快速迭代时期时，封测原材料，尤其是高端材料，非常容易成为制约整个产业发展的瓶颈。Microchip8、16 位 MCU 平均交期为 12-16 周，原 Atmel 的个别老型号交期超 16 周，如 ATTINY44A-MUR。个别车规级器件交期有延长趋势，因交期延长，囤货商价格收紧，价格已出现略微增长趋势。

海力士本月价格暴涨 60%

海力士本月 DDR 合约价环比暴涨 60%，其中服务器 DDR 上涨 66%，地洞 DDR 上涨 60%，价格接近 2018Q3 的历史峰值（0.97 美元/GB）。HBM3E 的出货量占总 HBM 出货量的三分之二，广泛配套英伟达等 AI 芯片。

三星通知新一轮涨价，普通客户涨幅 100%

三星原通知的 Q1 到货并没有实现，官方已通知新一轮涨价，给大客户的涨幅为 50%，其他客户的涨幅为 100%。由于 DDR4 及部分 DDR5 的价格涨幅过大，成本转嫁困难，工厂均已停止采购，导致现货交易停滞。但由于供应持续短缺，故市场报价仍持续高位。相较之下，DDR3 凭借低价优势迅速逆转了市场动向，成交量持续上升，随之带动价格小幅上涨。NAND 现货价格仍处于高位，加之消费需求疲软以及春节临近，导致大部分买家仍处于观望状态，然而卖家对价格走势积极，不愿让价出货，导致市场成交量表现平平。

镁光 LPDDR4 和 DDR4 供应紧张加剧价格波动

镁光整个 Q1 给到代理商的分货都有限，LPDDR4 和 DDR4 的到货都很少，导致 LPDDR4 的价格一路飙升，最常用的 512M 和 1G 涨幅基本在 20%，预计 26Q1 DRAM 合约价环比增长 55-60%，NAND Flash 涨幅 33-38%。

从 1 月 25 日镁光公布的最新合约价来看，DRAM 和 Flash 的价格并没有太大变化，甚至部分汽车型号略有下降，但由于市场上 LPDDR4 和 DDR4 的到货稀缺，所以价格一直都在变动，参考性不大。由代理商预测镁光 2026 年将持续涨价 60-70%，紧随三星步伐。据悉，镁光 2026 年将缩减中国区代理商，目前骁龙已确认被砍，国内最后可能只剩下安富利、世平和文晔三家代理商。最后，LPDDR4 和 LPDDR5 目前紧缺严重，代理商处预计 2 月份都无法到货。

闪迪企业级 SSD 价格翻倍

闪迪计划在 2026Q1 对企业级固态硬盘（SSD）实施价格翻倍策略，预计 NAND Flash 价格 3 月环比涨幅将突破 100%。

受益于人工智能数据中心的蓬勃发展，SanDisk 公布 2026 财年第二季度净利润为 8.03 亿美元，环比增长 617%，同比增长 672%。按业务部门划分，数据中心收入达到 4.4 亿美元，较上一季度的 2.69 亿美元增长 64%，较去年同期的 2.5 亿美元增长 76%。首席执行官大卫·戈克勒 (David Goeckeler) 说到，数据中心将在 2026 年超越智能手机，成为 NAND 闪存需求的最大来源。他指出，用于人工智能服务器的高端 NAND 闪存供应已经十分紧张，预计 2026 年下半年短缺情况将进一步加剧。

华邦 NOR Flash 和 DDR4 价格大幅增长

2026 年 1 月华邦 NOR Flash 第一季度环比涨价 20-30%，车规及工业级涨幅更高，DDR4 Q1 涨价 40-50%。

安森美进入新一轮涨价

受全球半导体原材料价格持续攀升及安世半导体事件引发的全球车规芯片供应紧张影响，安森美功率器件已正式进入新一轮涨价周期，目前部分物料价格涨幅已达 10%-20%，且受成本压力与订单排期驱动，后续价格大概率将持续上涨，建议科技提前规划并抓紧备货。交期方面，汽车级器件交期普遍在 12-16 周，热门 IGBT 模块交期延长至 20 周以上，SiC 功率器件交期达 16-20 周，供应持续紧张。

安世半导体多个产品线面临交付压力

安世半导体在中国市场的晶圆供应持续处于停滞状态，目前尚未有明确的恢复时间。安世目前正在积极寻找合格的替代晶圆供应商，但由于汽车二极管与晶体管对供应商的资质要求严格，目前仍面临合格供应商短缺的问题，使得这两类产品的供应风险尤为突出。车规级二极管、MOS 由于供应紧张，价格涨幅 10%-30%，高端型号溢价更明显，且交期延长至 12 周以上。另外，已有部分客户被告知，新材料尤其是用于传统医疗器械等高风险类别的物料，预计要 2026 年 7 月甚至更晚才能到货。预计从 26Q2 起，安世多个产品线将持续面临交期延迟的压力。

高端产品和不可替代产品引领 ADI 需求复苏

ADI 2025 财年营收达 110 亿美元，同比增长 17%，第四季度营收同比增长 26%，工业、通信等终端市场表现强劲。受汽车电子、AI 服务器、工业自动化等领域需求拉动，ADI 芯片需求持续回暖，尤其在高性能、不可替代的型号上（如车规级、军规级产品）。库存方面，渠道库存水位较低，部分热门料号交期延长，如 ADXL357BEZ 等；代理商库存持续减少，市场已出现扫货和囤货现象。订货交期较长，16-20 周，但交期并不稳定。

ADI 的涨价短期内并不会加快国产替代的步伐，核心原因并非价格，而是目前国产产品的可靠性与一致性仍存在明显差距，且国内硬件工程师人才短缺，制约了国产产品性能的提升。

瑞昱以太网芯片价格上涨

瑞昱 1 月份工业及车载以太网芯片低端、中端类芯片涨价 5-10%，高端类 AI 芯片溢价 20-30%。交期延至 6-8 周，高端交换机物料交期超半年。

恩智浦全面退出射频功率放大器业务

恩智浦传感器业务预计于明年年终完成交接。目前，汽车应用中的 NTM88 系列胎压监测传感器处于严重缺货状态，交期延长至 65 周。近年来，汽车、工业等领域需求持续增长，导致恩智浦对射频业务的资源支持减少。在多重因素影响下，恩智浦决定全面退出射频功率放大器业务，旗下 Echo 晶圆厂预计在 2027 年 Q1 完成最后一批氮化镓晶圆生产后关闭。

Marvell 营收创新纪录

Marvell 2026 财年第二季度营收创下 20.06 亿美元新纪录，数据中心业务占比高达 74%，同比增长迅猛。公司目标是讲 AI 业务的收入占比提升至 50% 以上，目前主要来自为亚马逊、谷歌、微软等客户设计的定制化 AI ASIC 芯片以及光模块 DSP 芯片等产品。综合来看，Marvell 正处于强劲的长期转型（从数据中心/AI）与显著的短期波动（市场情绪和产品周期）并存的状态。

交期方便，Marvell 近期处于缺货状态，加急费 30%。目前产能为饱和状态，订货交期大部分为 22 周以上，

大部分产能被挪去做 SOC 和光通信产品，都是 AI 相关的，所以网通类、工业商业类的开关产品交期可能会受到影响，交期逐渐拉长。

Altera 现货紧张，交期延长

Altera 目前终端订货延迟，现货紧张，EPC16/32 等终端芯片成市场扫货重点。交期大面积延迟，部分物料交期从 4-6 周延长至 16-18 周。5CE 系列交期从 28 周延长到半年以上，EP4/EPM 系列交期延长到 24 周左右。

AI 和新能源汽车需求驱动 TE 业绩增长

随着 AI 和新能源汽车领域的需求增加，TE 在 2025Q3 营收达 45.34 亿美元，同比增长 13.95%。在新能源汽车领域，TE 的高压连接器为特斯拉、比亚迪等头部车企提供电池管理系统连接器，单车平均搭载 35 个 TE 连接器。2025 年 Q3，亚洲市场（尤其是中国）电动车产量环比增长 40%，带动交通业务毛利率回升至 35%以上。AI 方面 TE 的数据中心高速连接器需求爆发，2025 年 Q3 数字数据网络（DDN）业务同比激增 77%，服务于英伟达、思科等客户，单台 AI 服务器搭载 20 组 TE 高速接口。全年 AI 相关收入预计突破 8 亿美元，占通信业务比重近 50%。2025 年铜价上涨，导致部分 TE 产品价格上涨，另外 TE 与欧盟的一些代理商在 2025 年 8 月初签订了欧洲代理商只能出货给欧盟地区的协议，导致目前 TE 连接器的供应受限。

AI 和新能源市场驱动 AVX 营业大幅增长

自 2025 年以来，由于 AI、新能源汽车、工业智能化等领域的需求增长，导致 AVX 价格持续增长，且交期也大幅延长。AI 服务器领域，单台英伟达 GB200 服务器钽电容用量达传统服务器的 8 倍（约 2000 颗），下一代 Robin 平台将增至 4500-5000 颗，带动 AVX 数据中心业务增长 120%。智能汽车领域，车载钽电容需求增长 35%（单车用量达 80-120 颗），MLCC 在 ADAS 系统中用量年增 25%，聚合物电容在 400V/800V 高压平台渗透率提升。工业自动化领域，2025Q3 后订单稳定，高压高容 MLCC 与聚合物电容需求增长 15%，适配工业机器人与 PLC 控制模块。

AVX 2025 年内实施了三轮涨价，聚合物钽电容涨幅达 30-45%，常规型号涨幅 10-20%，交期从 2024 年的

16-20 周延长至 38-52 周，高端型号（如 TCJ 系列）优先保供给英伟达、ADI 等 AI 巨头，中小客户订单已排至 2026 年 Q3。

AI 与新能源汽车市场需求驱动 HRS 业绩增长

HRS 目前的增长点还是在 AI、新能源汽车、工业自动化三大高增长赛道。HRS 的 MS 系列：高频连接器，支持 6GHz 传输，应用于 AI 数据中心高速背板和射频模块。HR10A+系列：工业级圆形连接器，支持 10Gbps 传输，用于 AI 机器人和智能制造设备，市场需求量逐步增加。汽车高压 800v 连接器在中国市场占比 80%。AU1 系列：USB Type-C 车载专用，支持 10Gbps + 传输，CPA 防误插设计，应用于车载信息娱乐系统。ZE05 系列：车规级高性能连接器，耐热 125°C，抗振 8.9G，广泛应用于动力系统和智能座舱。HRS 的在中国的工业自动化领域占比 15.3%，它的 ix Industrial 系列：兼容 Cat.6A (10Gbps) 标准，工业以太网通信，用于 PLC 与伺服驱动器高密度集成，FX8C-140P-SV2：0.5mm 超细间距，140pin 高密度，工业控制器专用，2025 年 Q2 出货量突破 50 万件。由于近年来金属价格持续上涨，HRS 在 25 年第三季度以来已经上涨了部分系列产品的价格，涨价幅度比较大的系列型号比如 ER8-20S-0.8SV-7H 从之前的 0.8u 涨到了 1.4usd 左右，HRS 的这一涨价策略针对全球市场，只保留了日本本土一些大客户的价格，其他客户只能被迫接受涨价。

Abracon 交期延长

Abracon 凭借石英+MEMS 双技术路线、全品类产品布局和快速定制服务，在汽车、IoT 等技术领域具有强劲竞争力。随着 5G、AI、IOT 等技术推动电子设备数量爆发式增长，对高精度时序和高效电源管理需求激增，另外新能源汽车和自动驾驶也对车规级电子元器件需求大幅增长，加之近几年全球金属的持续涨价与原材料紧张，导致了 Abracon 的交期从 8-10 周延长至 12-14 周。

行业趋势

全球电子协会发布的《2026 年人工智能和电子产品增长的关键趋势》

增长主要集中在人工智能基础设施、国防电子产品和能源系统领域，因此，到 2026 年，电子产品制造商必须进行战略性的产品调整。

在耐心的超大规模资本和长期规划的支持下，人工智能投资依然保持强劲势头，而能源基础设施（而非资金）正成为主要制约因素。

关税成为常态，推动供应链多元化，而潜在的法律逆转可能会释放再投资资本。

自动驾驶汽车和人形机器人达到运营里程碑，加速了对先进传感器、处理器、电源管理和制造技术的需求。

集中增长

经济增长将持续处于危险的狭窄区间。繁荣将集中在人工智能基础设施、国防电子产品和高收入消费者的支出领域，而这些领域之外的公司则面临重重阻力。对于电子产品制造商而言，成功完全取决于其产品是否与这些集中增长的领域相契合，而市场定位比以往任何时候都更加重要。

人工智能投资可持续性

人工智能投资不会像以往的科技泡沫那样破裂，因为它本质上与以往不同。超大规模数据中心运营商正在利用成熟的现金流进行长期投资，而不是像以往那样动用风险投资。这些公司明确地将人工智能投资视为长期布局，而非追求短期回报。他们的规划着眼于三、五、十年，并承认随着应用和用例的成熟，短期内的一些过剩产能最终可能会带来优势。这种以稳健业务为基础的长期投资策略，比以往的技术建设更具可持续性。真正的制约因素并非资金，而是能源基础设施。预计人工智能投资至少会持续到 2027 年中期。

关税作为实际运作手段

关税将在 2026 年从危机过渡到日常业务。企业已通过内部生产、地域多元化（尤其是在美墨加协定下的墨西哥）以及复杂的成本吸收策略来适应这一变化。但存在一个不确定因素：法院可能裁定某些关税非法，从而引发意外的退税，这相当于一种计划外的财政刺激，可以突然释放资金用于再投资。

能源受限的人工智能增长

到 2026 年，制约人工智能发展的将是电力基础设施，而非资本或创新。数据中心巨大的电力需求意味着能

源生产和输送能力将日益决定人工智能的部署速度。这将持续催生对电源管理组件、先进冷却系统和节能计算架构的需求。

自动驾驶汽车跨越门槛

自动驾驶汽车将在 2026 年从设想变为实际运营。虽然消费者拥有自动驾驶汽车仍遥遥无期，但无人驾驶出租车已实现商业化成熟。Waymo 累计行驶 3000 万英里，载客 1000 万人次，证明了该模式的可行性。预计自动驾驶汽车的地理覆盖范围将持续扩大，对传感器、处理器和复杂系统等实现自动驾驶功能的需求也将持续增长。

人形机器人加速发展

最近在拉斯维加斯举行的 CES 消费电子展重点展示了人形机器人，这表明未来 36 个月内，该领域将继续取得显著进展。我们目前正在讨论家用机器人的功能和可承受的价格，而这在几年前还显得不可思议。虽然机器人的广泛应用仍需时日，但这种加速发展对机器人本身及其制造系统都具有深远的影响。

展望未来

2026 年，专注于人工智能基础设施、能源系统和先进制造等增长领域的公司，即便面临经济不确定性，仍将迎来发展机遇。成功与否取决于战略定位、运营灵活性以及对由电力、政策和平台技术共同塑造的格局的适应能力。

SEMI 概述 2026 年美国政策重点，以支持半导体行业增长、创新和供应链稳定

SEMI 发布了其 2026 年美国政策战略：《保障半导体供应链，助力美国在人工智能领域保持领先地位》。该战略旨在增强美国竞争力，维持长期市场投资，并支持整个半导体生态系统的创新。这些重点体现了 SEMI 作为政策制定者值得信赖的合作伙伴的角色，以及其致力于推进切实可行、协调一致且以行业需求为导向的解决方案，从而在高度一体化的全球产业中巩固美国竞争力的承诺。

“半导体产业对现代经济的各个方面都至关重要，从人工智能和先进制造业到国家安全和劳动力发展，”SEMI 总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查表示。“随着全球竞争加剧和政策框架不断演变，美国能否继续保持半导体设计、制造和创新领域的领先地位，将取决于其政策执行是否清晰、可预测且具有前瞻性。”

今年，SEMI 的政策重点在于提供确定性、促进长期投资，并确保美国继续与全球网络保持连接，从而增强半导体制造业的韧性和可持续性。SEMI 2026 年美国政策战略强调了五个相互关联的领域，这些领域对于加

强美国的领导地位至关重要：

- 平衡的贸易政策，既能保障关键投入品的获取，又能避免对同一产品征收重叠关税，还能支持美国公司进入市场，同时推进国家安全目标。
- 建立与联邦、州和行业计划相协调的国家半导体人才培养体系，以满足整个半导体生态系统的关键人才需求。
- 长期的税收和研发激励措施，为多年投资提供可预测性，并支持整个半导体供应链（包括上游供应商）的创新。
- 继续实施 CHIPS 和科学法案，并制定前瞻性路线图以保持势头，确保授权资金转化为能力和创新。
- 务实的政策，在实现环境目标的同时，兼顾半导体制造的技术要求，以维持持续创新。

这些优先事项凸显了政策制定者与产业界早期开展有效沟通的重要性。鉴于半导体供应链的复杂性和投资规模，在制定过程中吸纳产业界技术意见的政策更有可能实现预期目标，同时避免产生意想不到的后果。

SEMI 发布的《2026 年美国政策战略》还强调了与美国盟友和伙伴协调的重要性，以及继续支持公私合作研究的重要性。半导体制造依赖于全球专业材料、设备和技术网络，而国际协调一致的政策有助于增强供应链韧性，保护共同安全利益，并维护美国的竞争力。

SEMI 美洲区总裁乔·斯托库纳斯表示：“SEMI 的方针以合作为基础。我们的会员企业正在以前所未有的规模投资美国，为全国各地社区带来数千个高薪高技能就业岗位。清晰的规则、可预测的激励措施以及协调一致的政策执行，能够最大限度地保障这些投资的成功。我们期待与政策制定者继续合作，确保美国半导体生态系统保持强劲、韧性和全球竞争力。”

SEMI 2026 美国政策战略将半导体行业定位为推动经济增长、创新和国家安全的建设性合作伙伴。通过合作、信誉和持续参与，SEMI 致力于确保美国半导体行业的下一阶段扩张能够为更广泛的经济带来持久的效益。

TrendForce 表示，CPU 和内存价格上涨的双重压力将导致 2026 年第一季度全球笔记本电脑出货量环比下降 14.8%

- 预计 2026 年第一季度全球笔记本电脑出货量将环比下降 14.8%，第二季度将出现小幅反弹。
- 内存、CPU、PCB、电池和电源管理芯片的价格都在上涨，这加剧了笔记本电脑的成本压力。
- 由于供应受限和品牌战略不明朗，2026 年全年笔记本电脑出货量预测同比下降 9.4%。

TrendForce 最新发布的笔记本电脑行业调查显示，自 2025 年下半年以来，全球笔记本电脑品牌一直面临着内存价格大幅上涨的困境。进入 2026 年初，他们又面临着 CPU 供应暂时短缺和价格上涨的局面。此外，PCB、电池和电源管理集成电路（PMIC）成本的上涨也加剧了这些挑战，预计这些因素将导致 2026 年

第一季度全球笔记本电脑出货量环比下降 14.8%，低于品牌最初的预期。

TrendForce 观察到，根据系统配置的不同，CPU 通常占笔记本电脑物料清单总成本的 15% 至 30% 左右。目前，大多数入门级和主流笔记本电脑主要采用英特尔处理器。然而，英特尔近期提高了低端 CPU 的价格，并且持续的供应短缺（预计将持续到 3 月之后）给产品规划和出货时间带来了压力。

预计 2026 年第一季度笔记本电脑 DRAM 和 SSD 的合同价格将大幅超出此前预期，环比分别上涨超过 80% 和 70%。此外，自 2025 年第四季度以来，笔记本电脑制造商积极的出货策略迅速降低了内存库存。随着内存生产商在 2026 年第一季度的供货率下降，品牌商的内存采购能力受到限制，这将扰乱生产计划和出货时间表。

TrendForce 指出，PCB 成本上涨的原因在于设计复杂性增加和铜价飙升。随着中高端笔记本电脑规格升级，主板层数也随之增加，PCB 成本结构性上涨将成为一种长期趋势。

规格升级推高了电池的单价，锂电池材料价格上涨也进一步推高了电池报价。与此同时，CPU 和 NPU 功耗的增加也推高了对电源管理芯片（PMIC）的需求。Wi-Fi 7 和 USB4 等新标准的采用也增加了相关芯片和连接器的成本。虽然这些组件的价格涨幅小于内存或 CPU 的单独涨幅，但它们的综合影响给利润通常很低的笔记本电脑品牌带来了沉重的财务负担。

尽管供应端风险不断增加，各品牌对 2026 年第一季度的出货量前景仍保持相对乐观。然而，TrendForce 认为，各品牌可能难以按时获得所有必要的零部件，预计 2026 年第一季度出货量将环比下降 14.8%。随着英特尔 CPU 供应的改善，预计 2026 年第二季度将出现小幅环比反弹。

TrendForce 已将 2026 年笔记本电脑出货量预测从同比下降 5.4% 下调至降幅更大的 9.4%。由于内存价格高企和 CPU 供应不稳定，市场面临更大的短期不确定性。展望未来，关键零部件供应的变化、品牌对成本的调整、库存水平、产品策略以及消费者对更高价格的接受程度等因素，将对 2026 年下半年的市场走向产生至关重要的影响。

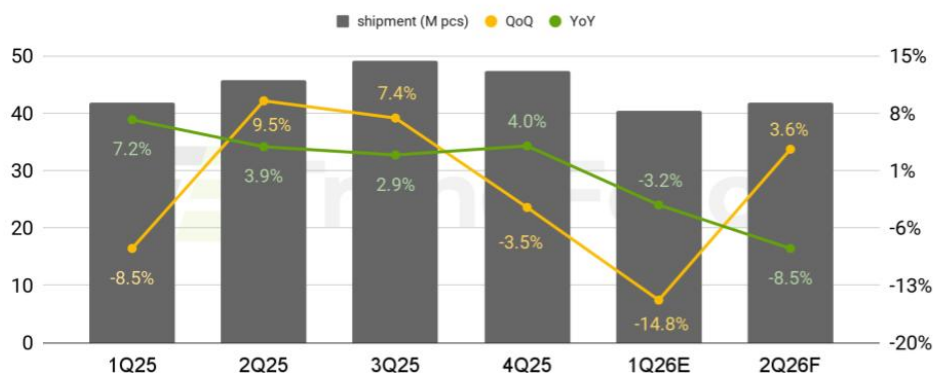
Notebook BOM Composition Before Component Price Hikes and 1Q26 Component Price Trend

Key Components	Average Share of BOM Costs (Before Price Hikes)	1Q26 Price Trend
DRAM+SSD	10-25%	NB DRAM expected to rise by at least 80% NB SSD expected to rise by at least 70%
CPU	15-30%	Price increase still under negotiation between buyers and sellers
Discrete GPU (if any)	0-25%	Price increase still under negotiation between buyers and sellers
Battery	5-10%	Price increase still under negotiation between buyers and sellers
PCB	3-5%	Price increase still under negotiation between buyers and sellers

Source: TrendForce, Jan. 2026

 **TrendForce**

Global Notebook Shipments, 1Q25-2Q26



Source: TrendForce, Jan. 2026

 **TrendForce**

高风险物料预警

Part Number	Manufacturer
E48SC12010NRFA	DELTA ELECTRONICS INC
EFM8UB31F40G-A-QFN24R	SILICON LABORATORIES INC
LM193AJ/883	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
BSM400GB60DN2	INFINEON TECHNOLOGIES AG
XC2C256-7CPG132I	XILINX INC
EPM7064BTC44-7N	ALTERA CORP
AD595AQ	ANALOG DEVICES INC

注：该部分数据来源于 ERAI，仅供参考。